

6387 **サムコ**

辻 理 (ツジ オサム)

サムコ株式会社社長

## 不況に動じない技術力で産業科学に貢献

### ◆2012年7月期第2四半期実績

2012年7月期第2四半期は、売上高20億61百万円(前年同期比21.2%減)、営業利益2億42百万円(同43.2%減)、経常利益2億24百万円(同42.9%減)、純利益1億29百万円(同42.6%減)であった。売上総利益率は、前年同期に比べ2.3ポイント改善し47.4%となっている。

地域別売上高は、国内が16億67百万円(前年同期比28.0%増)と、堅調であったが、アジアは2億91百万円(同74.6%減)であった。中国では金融引き締め策により設備投資の急激な減少が起こり、当社の主要製品においても顕著な影響が出た。特に中国・台湾のLED市場が低迷しているが、小幅な設備投資は動き始めており、下期には回復基調に転じる見通しである。北米は95百万円(同122.9%増)で、アメリカの景気が着実に回復基調となっていることから、下期には2億~3億円の大幅増加が見込まれる。欧州は4百万円(同88.7%減)であった。

品目別売上高では、CVD装置が3億77百万円(前年同期比36.1%減)、エッチング装置が11億60百万円(同22.8%減)である。洗浄装置は2億41百万円(同11.2%増)、前年同期に実績のなかったその他装置は8百万円であった。部品・メンテナンスは2億73百万円(同10.8%減)であるものの、一貫して増加基調であり、今後も微増が見込まれる。

市場別売上高として、研究開発用設備は安定した需要があるが、生産用設備が同27.4%減で、特にアジア向けの生産用が大幅に減少した。

用途別売上高では、オプトエレクトロニクス分野が前年同期比38.9%減、電子部品・MEMS分野が同74.4%増となり、特に電子部品のSAWデバイスやMEMS分野のドライエッチング装置などが増加に転じた。シリコン分野は同13.8%増、実装・表面処理分野が同27.0%減、表示デバイス分野が伸長、その他分野が同67.8%減である。

### ◆サムコの事業と現況

今期の方針として、海外展開、新製品投入・拡販、重点マーケット、“One Stop Solution”戦略を掲げている。

海外展開について、中国・台湾ではLEDの低迷は一過性のものであり、中規模程度のビジネス件数は大幅に増加している。台湾は、従来の価格重視からクオリティ重視となり、大手は日本メーカーと同等の製品開発を進める動きが顕著になった。現在中国では上海と北京、台湾では新竹と台南に営業・サービス拠点を持っているが、中国南部に新たな拠点を作って営業体制を強化し、有力大学との共同研究を進める。他のアジア地域の開拓としては、昨年よりシンガポールの販売拠点からインドへの拡販を図っており、当面は大学・研究機関への展開を進める。さらに、マレーシア、ベトナム、タイを今後の成長地域として重要視し、ベトナムには社員を派遣した。ヨーロッパは、ドイツ、チェコ、フランス、イタリアに代理店がある。イタリアでSTマイクロエレクトロニクス社と接触しており、パワーデバイスやMEMS分野での商談に期待しているほか、ドイツのオスラム社に対し製品のPRを続けている。昨年以降現地メーカーのグリーンデバイスに関する注目度が非常に高く、引き続き拡販に注力する。北米市場は、シリコンバレーを中心に展開しているが、一昨年にはノースカロライナ州に拠点を開設した。ここからボストンへの客先

発掘を進めており、すでに獲得した顧客をベースに周辺に拡販する。研究開発用が中心ではあるが、シリコンバレーには生産メーカーもあり、展示会展展や学会発表を通じ、当社社名の浸透に努める。

アジア向けに新製品を積極的に投入し、昨年末に販売を開始したドライエッチング装置 RIE-331iPC は、占有面積を縮小し、重量を軽くして送料の低減を図るなどの改良を行っている。円高で割安となった韓国や台湾などから部品を調達することで、従来の同程度の機種に比べコストを約 30%低減した。他の CVD 装置についても同様に 2~3 割のコストダウンができる見通しのなか、円高も一服する見込みであることから、今後はある程度以上の価格競争力が付く。

重点マーケットとして、オプト分野では、LED、半導体レーザー、高周波デバイスがある。同時に、当社の強みの一つであるガリウムナイトライドやシリコンカーバイドといったワイドバンドギャップの材料をパワーデバイスに展開し、これら環境エレクトロニクス分野を開発・開拓することが重点目標の一つである。

MEMS 分野では製品のラインナップ化を進め、小口径のウエハの研究開発機、大口径のウエハのセミ量産機に加え、生産用向け本格量産機の計 3 機種を市場に出しており、研究開発から本格的な生産用途まで全ての顧客ニーズに対応可能である。TSV(三次元パッケージ)では中規模の生産ラインに対応し、DRAM ではなく異種混合デバイスのマーケットに特化していく。このラインナップ化として、最終プロセスである銅メッキ技術の完成を図っている。これができるれば、貫通孔形成、側壁絶縁膜形成、下部電極露出についてはすでに加工装置を持っているため、一貫したソリューション提供ができる。TSV の貫通孔形成では、海外メーカーによるデータのコンペにおいて、当社がもっとも優れているとの評価を得た。TSV の側壁絶縁膜形成でも、優れたカバレッジ性の成膜技術において他の追随を許さない世界トップの技術を持っている。絶縁膜形成 CVD 装置は、すでにラインナップ化が完成し、量産用の新製品も市場に投入している。当社製品の性能が認められ、今秋にはアメリカの学会で招待講演を行う運びとなった。

パワーデバイスの分野では、当面はシリコンカーバイドを中心に成長を図りつつガリウムナイトライドを推し進め、LED で培ったエピタキシャル成長の技術を電子デバイス用途として展開する。現在は、シリコンカーバイドのドライエッチング装置とゲートオキシドの形成を扱っている。素子構造は、シリコンの場合に比べ、GaN-HEMT 構造にすれば小型化でき耐圧も高い。シリコンカーバイドはドライエッチが非常に難しい材料であるが、これを当社の得意技術で加工している。

LED チップには、主にガリウムナイトライドのメサ加工が利用されているが、サファイアの PSS 加工では、プロセス条件で加工形状の制御を行い、発光効率を向上させることができる。当社は両方のエッチングを手掛けており、そのノウハウを顧客に提供している。LED 生産用装置においても、CVD 装置およびエッチング装置について処理能力別に各 3 機種のラインナップを整えた。

“One Stop Solution”戦略を LED、パワーデバイス、TSV 等の分野で進めており、CVD 装置、エッチング装置、エピタキシャル成長装置、洗浄装置などを組み込みながらトータルで提供する。ボリューム拡大の目的もあるが、当社に依頼することで全てが解決する利便性を高める狙いがある。

## ◆中期経営計画

当社は薄膜技術で世界の産業科学に貢献することを経営理念としている。2012 年 7 月期から 2014 年 7 月期までの中期経営計画では、収益性としては、売上高利益率 50%、経常利益率 20%以上、2015 年 7 月期には売上高 100 億円超を目標としている。

当社の事業は半導体製造装置だけではなく、異分野や他の市場である太陽電池やパワーデバイスを初めとする新エネルギー開発、半導体の表面加工技術を応用したインプラントなどの医療技術、バイオセンサーなどのバイオ関連、環境・リサイクル分野などへ当社のコアである薄膜技術をベースに開拓を進め、他社とのアライアンスも進める。

今期は、非シリコン分野でシリコンカーバイドおよびガリウムナイトライドに焦点を絞り、深く広い取り扱いを進める。また、グローバル市場への布石として、特にインドおよび東南アジアの開拓を進める。さらに、成長力と収益力を強化するとともに、異分野への進出並びに他社とのアライアンスを進めることで事業拡大を図る。日本国内は将来的に大きな市場を見込めないなか、グローバルな事業展開をするには人材によるところが大きい。すでに外国人の採用を進めているが、異なる文化を持つ海外市場での展開を着実に進めるためにも、引き続き人材育成による競争力強化に取り組んでいく。

### ◆ 質 疑 応 答 ◆

**TSV に関し、業界は量産化に向かって動いているが、これに関する変化はあるか。**

メモリデバイスの高集積化は大手が手掛けると思われ、当社では検討していない。それ以外の異種混合プロセスにおいて、化合物とシリコンおよびその多層化に動いている。カメラ、複写機、プリンタなどのデジタル機器では世界で大きな動きがあり、新しい機器には専用のチップを作るため、これらに食い込んでいく。

**有機 EL 関連では、どのような装置を扱っているのか。**

1つは封止膜で、これはシリコンナイトライドを使用した製品がもっとも良い。もう1つは、基板に塗布するITO膜の表面を改質する処理を行っている。これらについては、国内のほとんどの有力メーカーと取引がある。また、フレキシブル基板で、フィルムにどう対応するかを進めることが今後のビジネスチャンスになる。

**他社と比較した強みなど、御社の競争力を教えてほしい。**

当社には、独自のプロセステクノロジーがあり、パワーデバイスでシリコンカーバイドを望むとおりに加工するにはどのような条件がいるのか、LEDでサファイアの基板を望む形状に加工するにはどうすればよいかといった技術が強い。当社製品のラインナップはさほど広くなく、材料も数種に絞り込んでおり、これらについては世界中でどこでも戦えると自負している。

(平成 24 年 3 月 12 日・東京)